DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04127605 **Image available**

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **05-119305** [JP 5119305 A]

PUBLISHED: May 18, 1993 (19930518)

INVENTOR(s): TAKANASHI HIROSHI

FUKUCHI TOSHIO

MISONO KENJI

IWAMOTO MAKOTO

ISOHATA KYOHEI

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 03-309880 [JP 91309880]

FILED: October 28, 1991 (19911028)

INTL CLASS: [5] G02F-001/1333; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

August 31, 1993 (19930831)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R020 (VACUUM TECHNIQUES)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1604, Vol. 17, No. 481, Pg. 127,

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the degradation in yield and reliability by subjecting the surface of synthetic resin substrates to a degassing treatment to release the gases adsorbed thereon, then subjecting the surfaces to a prescribed treatment.

CONSTITUTION: Electrode substrates 1, 2 constituted by forming transparent electrodes 1b, 2b on synthetic resin substrates 1a, 2a are subjected to the release of the gases adsorbed on the substrate surfaces by placing the synthetic resin substrates 1a, 2a just prior to the treatment to form the electrodes in a heat and evacuated atmosphere. The transparent electrodes 1b, 2b are formed by sputtering or vapor deposition on the synthetic resin

substrates 1a, 2a subjected to the degassing treatment. The heating treatment is executed by setting the heating temperature of the synthetic resin substrates 1a, 2a during the degassing treatment at the temperature higher than the substrate heating temperature at the time of the treatment to form the electrodes. Then, the high vacuum similar to the case glass substrates are used is easily obtained even in the case where the synthetic resin substrates 1a, 2a are used. The transparent electrodes 1b, 2b having the good adhesion and strength are formed.

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-119305

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51) Int. Cl. s

識別記号

500

7724-2K

G02F 1/1333 G09F 9/30

C 7926-5G

審査請求 未請求 請求項の数5 (全6頁)

(21)出願番号 特願平3-309880 (71)出願人 000005049 シヤープ株式会社 (22)出願日 平成3年(1991)10月28日 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 (72)発明者 高梨 宏 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号シヤ ープ株式会社内 (72)発明者 福地 俊生 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号シヤ ープ株式会社内 (72)発明者 御園 健司 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号シヤ ープ株式会社内 (74)代理人 弁理士 鈴木 ハルミ 最終頁に続く

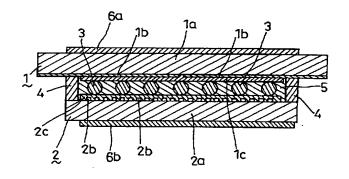
FΙ

(54) 【発明の名称】液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 合成樹脂基板表面に吸着している吸着ガスの 放出に起因する歩留まりの低下、信頼性の低下などの悪 影響を防止する。

【構成】 透明電極 1 b, 2 bを形成した合成樹脂基板 1 a, 2aを電極板1,2として用いた液晶表示装置におい て、脱ガス処理を行って合成樹脂基板 1 a, 2 a表面に吸 着されているガスを放出させた後、透明電極形成処理、 シール印刷処理、液晶注入処理を行うようにした。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】合成樹脂基板に透明電極が形成された2枚 の電極板を適宜間隔をもって対向させ、両電極板の周縁 をシール材にて密封して形成される密封空間に液晶を注 入するようにした液晶表示装置の製造方法において、透 明電極をスパッタあるいは蒸着により合成樹脂基板上に 形成する電極形成処理の直前に、該合成樹脂基板を加熱 して真空引き雰囲気中におくことにより基板表面の吸着 ガスを放出させる脱ガス処理を行うようにしたことを特 徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】電極形成処理時の基板加熱温度よりも高温 で合成樹脂基板を加熱した後、所定の電極形成処理を実 施するようにしたことを特徴とする請求項1記載の液晶 表示装置の製造方法。

【請求項3】合成樹脂基板に透明電極が形成された2枚 の電極板を適宜間隔をもって対向させ、両電極板の周縁 をシール材にて密封して形成される密封空間に液晶を注 入するようにした液晶表示装置の製造方法において、熱 硬化性のシール材を電極板に印刷するシール印刷処理の 直前に、両電極板を処理環境における水の沸点以上の温 20 度で加熱し、その直後に真空引き雰囲気中に移送して基 板表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を行うように したことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】合成樹脂基板に透明電極が形成された2枚 の電極板を適宜間隔をもって対向させ、両電極板の周縁 をシール材にて密封して形成される密封空間に液晶を注 入するようにした液晶表示装置の製造方法において、液 晶注入処理の直前に、液晶注入前の液晶表示装置を真空 引き雰囲気中で加熱することにより電極板表面およびシ ール材表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を行うよ 30 うにしたことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】上記ガス処理時に、両電極板を外面側から 挟持して電極板の変形を防止する挟み込み治具を用いる ことを特徴とする請求項4記載の液晶表示装置の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ノート型あるいはパー ムトップ型パソコン、ワープロ、電子手帳などに用いる 軽量で薄型の液晶表示装置の製造方法に関するものであ 40 る。

[0002]

【従来の技術】従来、軽量で薄型の液晶表示装置とし て、ガラス基板に透明電極を形成した電極板を用いたも のがあった。ところが、最近、ノート型あるいはパーム トップ型パソコン、ワープロ、電子手帳などに用いるた め、より軽量で薄型の液晶表示装置が要求を満足させる ために、電極板として合成樹脂基板上に透明電極を形成 したものを用いた液晶表示装置が提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 合成樹脂基板に透明電極を形成した電極板を用いた従来 例にあっては、合成樹脂表面に吸着いている吸着ガスに 対する処理が行なわれていなかったので、吸着ガスに起 因する歩留まりの低下、信頼性の低下などの悪影響があ るといる問題があった。すなわち、合成樹脂基板として は、アクリル系、エポキシ系、ポリエチレン系、ポリカ ーポネート系、ポリエチレン系などのプラスチックフィ ルムが用いられるが、これらの素材は、いずれもミクロ 的に見るとスポンジのような構造になっており、ガスや 水を吸着しやすい性質を持っている。したがって、製造 工程中の加熱処理によって合成樹脂基板表面に吸着され たガス(水蒸気を含む)が放出されると、処理条件の変化 や気泡発生などの悪影響が生じるという問題があった。

【0004】たとえば、スパッタあるいは蒸着により合 成樹脂基板上に透明電極を形成する電極形成処理におい て、高真空雰囲気中で基板を高温度に加熱して透明電極 を形成(スパッタあるいは蒸着)する必要があるが、ガラ ス基板を用いた場合に比較して高真空を得るのが非常に むづかしく、密着度および強度が良好な透明電極が形成 できないという問題があり、クラックが発生しやすい、 剥がれやすい、キズがつきやすい、断線が発生しやすい などの不都合が生じていた。この高真空を達成できない 原因は、湿式洗浄工程などで合成樹脂基板の表面に吸着 されているガスや水(水蒸気)が、真空雰囲気中での加熱 によって放出されるためであると考えられる。

【0005】また、シール材を電極基板に印刷するシー ル印刷処理前に行なわれるエッチング処理や配向膜形成 処理後の洗浄工程によって合成樹脂基板の表面に多量の 水分やガスが吸着されているので、この合成樹脂基板に シール材を印刷して貼り合わせ、熱硬化処理(加圧、加 熱)を行うと、合成樹脂基板表面に吸着されている多量 のガスがシール材内に放出され、シール材内気泡となっ て現れる。このシール材内気泡はシール強度を低下させ るだけでなく、シール材のバルク破壊によって気密性を 低下させ、減圧含浸注入法により液晶を注入するとき、 液晶層内に気泡が混入してしまい、信頼性の低下や、耐 候性が著しく損なわれるという問題があつた。

【0006】さらにまた、ガラス基板を用いた場合に は、液晶注入処理時に行なわれる真空引きだけで十分な 脱ガス効果が得られるが、合成樹脂基板を用いた場合、 この液晶注入処理時の真空引きでは十分な脱ガス効果が 得られず、液晶注入後に気泡が発生するという問題があ った。特に、10cm×15cm程度の大型表示装置の場合 には、液晶層内に必ず気泡が発生するという問題があっ た。

【0007】本発明は上述の点に鑑みてためされたもの であり、その目的とするところは、合成樹脂基板表面に 吸着している吸着ガスに起因する歩留まりの低下、信頼 50 性の低下などの悪影響を防止することができる液晶表示

装置の製造方法を提供しようとするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、合成樹脂基板 に透明電極が形成された2枚の電極板を適宜間隔をもっ て対向させ、両電極板の周縁をシール材にて密封して形 成される密封空間に液晶を注入するようにした液晶表示 装置の製造方法であり、請求項1の製造方法は、透明電 極をスパッタあるいは蒸着により合成樹脂基板上に形成 する電極形成処理の直前に、該合成樹脂基板を加熱して 真空引き雰囲気中におくことにより基板表面の吸着ガス 10 を放出させる脱ガス処理を行うようにしたものである。

【0009】請求項3の製造方法は、熱硬化性のシール 材を電極板に印刷するシール印刷処理の直前に、両電極 板を処理環境における水の沸点以上の温度で加熱し、そ の直後に真空引き雰囲気中に移送して基板表面の吸着ガ スを放出させる脱ガス処理を行うようにしたものであ る。

【0010】請求項4の製造方法は、液晶注入処理の直 前に、液晶注入前の液晶引装置を真空引き雰囲気中で加 熱することにより電極板表面およびシール材表面の吸着 20 ガスを放出させる脱ガス処理を行うようにしたものであ る。

[0011]

【作用】本発明方法は上述のように構成されており、合 成樹脂基板を用いた液晶表示装置において、脱ガス処理 を行って合成樹脂基板表面に吸着されているガスを放出 させた後、所定の処理を行うようにしているので、合成 樹脂基板表面に吸着している吸着ガスに起因する歩留ま りの低下、信頼性の低下などの悪影響を防止することが できるようになっており、請求項1の製造方法にあって 30 は、透明電極形成処理の直前に、合成樹脂基板を加熱し て真空引き雰囲気中におくことにより基板表面の吸着ガ スを放出させているので、ガラス基板を用いた場合と同 様の髙真空が容易に得られ、密着度および強度が良好な 透明電極が形成できる。

【0012】また、請求項3の製造方法においては、熱 硬化性のシール材の印刷処理の直前に、両電極板を処理 環境における水の沸点以上の温度で加熱し、その直後に 真空引き雰囲気中に移送して基板表面の吸着ガスを放出 させる脱ガス処理を行い、電極板にシール材を印刷して 40 熱硬化処理を行っているので、合成樹脂基板表面に吸着 されているガスがシール材内に放出されることがなく、 シール材内気泡によるシール強度の低下、シール材のバ ルク破壊による気密性の低下が生じず、減圧含浸注入法 により注入される液晶層内に気泡が混入するのを防止で き、信頼性、耐候性が損なわれることがない。

【0013】さらにまた、請求項4の製造方法において は、液晶注入処理の直前に、液晶注入前の液晶表示装置 を真空引き雰囲気中で加熱することにより電極板表面お よびシール材表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を 50 行っているので、大型表示装置を形成する場合にあって も、液晶層内に気泡が発生するのを防止できる。

[0014]

【実施例】図1は本発明に係る液晶表示装置の一実施例 を示すもので、上下2枚の電極板1,2は、アクリル系 の合成樹脂基板 1 a, 2 aに酸化インジウムよりなる透明 電極 1 b, 2 bがスパッタあるいは蒸着処理により形成さ れ、この透明電極 1 b, 2 bに配向膜 1 c, 2 cを覆着して形 成されている。このようにして形成された2枚の電極板 1,2は、ビーズ状のスペーサ3によって適宜間隔をも って対向配置され、周縁を熱硬化性のシール材4にて密 封して形成される密封空間に液晶5を減圧含浸注入法に より注入される。また、電極板1,2の外面には偏光板 6a,6bが配置される。

【0015】ここに、合成樹脂基板1a,2a上に透明電 極 1 b, 2 bが形成された電極板 1, 2 は、電極形成処理の 直前の合成樹脂基板 1 a, 2 aを加熱し真空引き雰囲気中 におくことにより基板表面の吸着ガスを放出させ、脱ガ ス処理された合成樹脂基板 1 a, 2 aに透明電極 1 a, 2 aを スパッタあるいは蒸着により形成しており、脱ガス処理 中における合成樹脂基板1a,2aの基板加熱温度を、電 極形成処理時の基板加熱温度よりも20℃程度高く設定 (電極形成処理時の基板加熱温度が100~120℃の 場合、脱ガス処理の基板加熱温度を130~140℃) し、 $1 \sim 2$ 時間の加熱処理を行うようにしている。たと えば、厚さが0.4mmのアクリル系の合成樹脂基板1a, 2aに酸化インジウムを真空雰囲気中(2×10⁻¹ Torr 以下)でスパッタして透明電極 1b, 2bを形成する場合に おいて、スパッタ前の脱ガス処理の基板加熱を140 ℃、1.5時間とし、スパッタ処理の真空引き開始時の 基板温度を130℃、所定真空度に達してスパッタする 時の基板加熱温度を120℃とすれば、20℃の温度差 で脱ガス処理が行なわれ、そのままスパッタ処理の真空 引きが実施できるので、真空引きの工程を簡略化できる ことになる。

【0016】以上のように、スパッタ、蒸着などにより 透明電極 1 b, 2 bを形成する電極形成処理の直前に、合 成樹脂基板 1 a, 2 aを加熱して真空引き雰囲気中で基板 表面の吸着ガスを放出させているので、合成樹脂基板1 a, 2aを用いた場合にあっても、ガラス基板を用いた場 合と同様の高真空が容易に得られ、密着度および強度が 良好な透明電極 1 b, 2 bが形成できる。また、電極形成 処理時の基板加熱温度よりも高温で合成樹脂基板 1a, 2 aを加熱した後、所定の電極形成処理を実施することに より、脱ガス処理を確実かつ簡単に行うことができる。 【0017】図2ないし図5は、熱硬化性のシール材4 にて両電極板1,2を貼り合わせる工程の説明図であ り、透明電極 1 b, 2 b および配向膜 1 c, 2 c が形成された 電極板1,2を貼り合わせるためのシール材4を印刷す るシール印刷処理の直前に、図2に示すように、コモン

10

0としては、実施例ではガラスを用いているが、プラス チック、金属を用いても良い。

【0020】以上のように、液晶注入処理の直前に、液晶注入前の液晶表示装置を加熱して真空引き雰囲気中におくことにより、電極板1,2表面およびシール材4表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を行っているので、大型液晶表示装置を形成する場合にあっても、液晶層内に気泡が発生するのを防止でき、表示品質および信頼性の向上を図ることができる。また電極板1,2を外面側から挟持する挟み込み治具10を用いているので、加熱、真空引きによる脱ガス処理時に外力によって合成樹脂基板1a,2aが変形するのを確実に防止できる。さらに、脱ガス処理として真空引きに加熱処理を併用しているので、短時間で吸着ガスを放出させることができる。しかも、脱ガス処理における真空引きは、後の注入処理時における真空引き工程と一連の処理となり、処理時間の短縮、製造設備の簡略化を図ることができる。

【0018】以上のように、シール印刷処理前に、電極板1,2の合成樹脂基板1a,2a表面に吸着されている水分やガスを放出させ、シール材4を印刷して貼り合わせて熱硬化処理を行っているので、合成樹脂基板1a,2a表面に吸着されているガスがシール材4内に放出されることがない。したがって、シール材内気泡によるシール強度の低下、シール材4のバルク破壊による気密性の低下が生じず、密閉空間に減圧含浸注入法により注入される液晶層内に気泡が混入するのを防止でき、信頼性、耐候性が損なわれることがなく、高表示品質な大型の表示装置を安定に供給できる。

[0021]

【0019】図6は他の実施例を示す断面図であり、図 1の実施例の構成にハードコート7、アンダーコート 8、トップコート9を付加したものであり、基本構成お よび表示動作は前記実施例と同様である。図7は、液晶 30 注入処理の直前に行なわれる脱ガス処理の説明図であ り、液晶5を注入する前の液晶表示装置の両電極板1. 2を挟み込み治具10にて外面側から挟持し、真空引き 雰囲気中で加熱することにより電極板1,2表面および シール材4表面に吸着されているガスや水分を放出させ るようにしている。ここに、合成樹脂基板 1a, 2 aとし てエポキシ系のもの(240×110mm)を用い、脱ガス 条件を130℃で30分の加熱、1 Torrの真空引きと し、液晶注入処理時の真空引きを5×10⁻¹ Torrで1 時間とし、脱ガス条件を変えた場合の気泡の発生をチェ 40 ック(130℃で30分加熱後に徐冷した場合の気泡評 価)は以下のようになっている。すなわち、加熱処理を しないで脱ガス処理を行うと、気泡が発生しないように するために50時間の真空引きが必要となり、量産工程 に導入することはむづかしいが、加熱処理を行うことに より、真空引きを4時間に短縮でき、量産工程への導入 は容易になる。なお、加熱と同時に真空引きを行うよう にしても良いことは言うまでもない。また、合成樹脂基 板1a,2aとしてアクリル系のものや、PES、PE T、ADCを用いた場合も同様である。挟み込み治具1 50

【発明の効果】本発明方法は上述のように構成されてお り、合成樹脂基板を用いた液晶表示装置において、脱ガ ス処理を行って合成樹脂基板表面に吸着されているガス を放出させた後、所定の処理を行うようにしているの で、合成樹脂基板表面に吸着している吸着ガスに起因す る歩留まりの低下、信頼性の低下などの悪影響を防止す ることができるようになっており、請求項1の製造方法 にあっては、スパッタ、蒸着などにより透明電極を形成 する電極形成処理の直前に、該合成樹脂基板を加熱して 真空雰囲気中におくことにより基板表面の吸着ガスを放 出させているので、ガラス基板を用いた場合と同様の高 真空が容易に得られ、密着度および強度が良好な透明電 極が形成できるという効果がある。また、請求項2のよ うに、電極形成処理時の基板加熱温度よりも高温で合成 樹脂基板を加熱した後、所定の電極形成処理を実施する ことにより、脱ガス処理を確実かつ簡単に行うことがで きる。

【0022】また、請求項3の製造方法においては、熱硬化性のシール材を電極板に印刷するシール印刷処理の直前に、両電極板を処理環境における水の沸点以上の温度で加熱し、その直後に真空引き雰囲気中に移送して基板表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を行い、シール印刷処理前に合成樹脂基板表面に吸着されている水分やガスを放出させた後、電極板にシール材を印刷して熱硬化処理を行っているので、合成樹脂基板表面に吸着されているガスがシール材内に放出されることがなく、シール材内気泡によるシール強度の低下、シール材のバルク破壊による気密性の低下が生じず、減圧含浸注入法により注入される液晶層内に気泡が混入するのを防止でき、信頼性、耐候性が損なわれることがないという効果がある。

【0023】さらにまた、請求項4の製造方法において

7

は、液晶注入処理の直前に、液晶注入前の液晶表示装置 を真空引き雰囲気中で加熱することにより電極板表面お よびシール材表面の吸着ガスを放出させる脱ガス処理を 行っているので、大型表示装置を形成する場合にあって も、液晶層内に気泡が発生するのを防止できるという効 果がある。また、請求項5のように、両電極板を外面側 から挟持して電極板の変形を防止する挟み込み治具を用

を確実に防止できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す断面図である。

いれば、加熱、真空引きによる脱ガス処理時の基板変形

Źα

- 【図2】加熱処理工程図である。
- 【図3】脱ガス処理工程図である。

【図4】スペーサとシール材を設ける工程図である。

- 【図5】両電極板の貼り合わせ工程図である。
- 【図6】他の実施例の断面図である。
- 【図7】同上製造工程の説明図である。

【符号の説明】

- 1,2 電極板
- 1a,2a 合成樹脂基板
- 1b, 2b 透明電極
- 3 スペーサ
- 10 4 シール材
 - 5 液晶
 - 10 挟み込み治具

【図1】 【図2】 1 気圧110℃で加熱 【図4】 2b 2b Ìc 【図3】 真空1Torr以下 【図7】 【図5】 [図6] 10

フロントページの続き

(72)発明者 岩本 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号シヤープ株式会社内

(72)発明者 磯畑 恭平

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号シヤープ株式会社内